

AEC/APC Symposium Asia 2011 ネットワークエキジション(ブース出展)ご案内

名称: AEC/APC Symposium Asia 2011 ネットワークエキジション
 併催行事: AEC/APC Symposium Asia 2011
http://www.semiconportal.com/AECAPC/index_j.html
 主催: ISMI、ISSM
 会期: 2011年11月9日(水)
 会場: 学術総合センター 一橋記念講堂
<http://www.zam.go.jp/i00/i0000000.htm>
 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目1番2号
 Tel:03-4212-6321 Fax:03-4212-6300

本案内の対象者

本案内は半導体製造に関わる装置・機器・材料・ソフトウェアまたはIPなどを提供するサプライヤーならびに学術関係者の皆様を対象にしています。

AEC/APC Symposium Asia は、装置・プロセスの自動診断・最適化など、よりインテリジェントで高効率な生産システムについて世界中からこの分野のプロフェッショナルが参加されます。フォーカスした領域の専門家にむけて、新しい技術、装置、システム技術をアピールし、次のような機会を提供いたします。

- 1) 次世代半導体生産向け装置・プロセス制御に関わるソリューションの提示とビジネスの紹介
- 2) 会議参加者との交流を通じて上記分野に関わる問題点ならびにアプローチの把握
- 3) ビジネス関係構築の機会

AEC/APC Symposium Asia ネットワークエキジションの概要

ネットワークエキジションではサプライヤーの皆様が会場に設置されたブース内で自由に製品紹介を行うことができます。

また、AEC/APC Symposium Asia 会議そのものへの論文投稿と、ネットワークエキジション参加を連携して行うこともできます。たとえば、投稿論文では純粋に技術的側面からの提案を行い、ネットワークセッションを通じて、
 -Image of Booth cubicle-

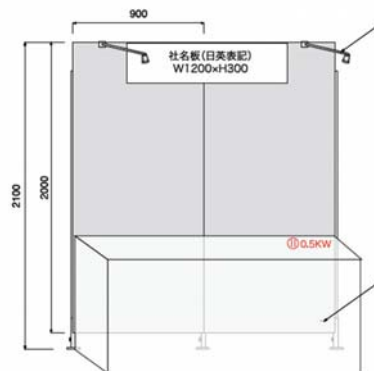
ただし、論文の審査は、ネットワークエキジションへの参加可否とは全く独立して行われます

ブース仕様

以下の基礎ブースを準備いたします。

- 1) バックパネル (幅 1.8m 高さ 2.1m)
- 2) テーブル (奥行き 0.6m 幅 1.5m 高さ 0.7m)
- 3) コンセント(500W) 1個
- 4) アームスポット 2個
- 5) 社名板 (和英併記)

資料掲示可能スペースは、幅 1.5m 高さ 1.4m を目安として下さい。

**参加申し込み概要**

- 1) **参加費用 120,000 円(税込)／1ブース**
 *スポンサーとなられた企業様が同時にネットワークエキジションに参加される場合、**100,000 円(税込)／1ブース**の割引となります。
- 2) **参加人数および特典**
 1ブースにつき1名様まで、AEC/APC Symposium Asia 2011 セッションに、一般 30,000 円(早期割引 25,000 円)のところ無料でご参加頂けます。
- 3) 半導体製造に関わるものであれば、業種や業態ならびに機関などによる参加の制限はありません。
- 4) 1ブースを最小単位、最大2ブースとします。
- 5) 申し込み期限: 2011年8月31日(水)
- 6) お申し込み方法: 添付の申込書にある申込書にご記入の上、事務局にメールもしくは Fax でお送り下さい。
- 7) ブース位置につきましては、AEC/APC Symposium Asia 2011 プログラム委員会にて、該当カテゴリー(下記の論文エリアを参照)などを鑑み決定します。
- 8) 申し込みブースが予定数(20ブース)を超えた場合は、調整をお願いすることがあります。

解約について

原則として、参加申込書確定通知後のキャンセルはご容赦お願いします。やむなく取り消しをされる場合には文書にてご連絡下さい。この場合、下記のキャンセル料をお願いいたします。

申込書確定通知後～2011年8月31日まで	ブース料の50%
2011年9月1日以降	ブース料の100%

ネットワークエキジビション参加者の皆様への留意事項

- 1) 20ブースほど用意する予定です。これを超えて参加申し込みが合った場合には、プログラム委員会で参加の可否を審査いたします。
- 2) できるだけAEC/APC Symposium Asia 2011のテーマに沿った製品展示ならびにソリューションの提案をお願いいたします。
- 3) 掲示物は英語または日英併記です。英文での説明は必須です。
 - 1) 製品およびパンフレット等の持込は自由です。
 - 2) 2名様を超えるAEC/APC Symposium Asia 2011参加者は、通常のAEC/APC Symposium Asia 2011参加登録費用が必要です

今後のスケジュール

2011年8月31日 出展申込締切
 2011年9月30日 出展料お支払い期限
 2011年11月9日 午前 搬入・セットアップ
 2011年11月9日 20:00- 撤去

★AEC/APC Symposium Asia 2011 について

AEC/APC Symposium は、半導体メーカーと装置、材料、ソフトウェア、センサー、メトロロジーメーカーが一堂に会し、データ指向、自動診断などを通じて、よりインテリジェントで高効率な生産システムの構築を議論する場を提供しており、毎年、世界3ヶ所(欧(3～4月)、米(9～10月)、アジア(台湾・日本、11～12月開催))で開催されています。

米国では既に22回、欧州では11回、アジアでは2003年から2006年までISMI/TSIA(台湾半導体工業会)共催で台湾にて開催され、2007年の日本での第一回を機会に、台湾・日本と毎年交互開催されることになった次第です。日本開催は、奇数年(2009年、2011年、2013年・)となります。

半導体の最先端の生産技術では、製品寿命が短い SoC (System-on-Chip) ではモデルを利用した予測ベースの科学的生産技術の確立が必要とされていること、DFM(Design for Manufacturing 製造容易化設計)による製造と設計の連携が一層重要になることから、装置・プロセスの制御モデル化やEES(装置エンジニアリングシステム)を用いた装置詳細データの収集が必要とされること、さらには先端デバイスの枚葉処理もプロセスモデルが基礎となることから、日本の業界でも、装置やプロセスの制御技術をモデルベースで扱い論議する AEC/APC Symposium への注目が高まっております。

欧米亜の生産技術の核ともなっているこの分野において、日本でも、プロセス制御性向上、設備生産性向上、資材費低減活動などに新たな方向性を見出す機会を提供する本シンポジウムの位置づけは非常に重要です。

AEC/APC Symposium Japan は ISSM(国際半導体生産技術シンポジウム)と、SEMATECH 傘下の ISMI(International SEMATECH Manufacturing Initiative)が共催して開催されております。

★AEC/APC Symposium Asia 2011 論文エリア

論文募集エリアの詳細

Equipment and Process control methodology:
 Fault detection and classification
 Statistical process control
 Run-to-run control
 Enhanced equipment quality assurance
 Productivity & tool optimizations:
 Throughput enhancement
 Uptime ratio improvement
 Cost reduction
 Non-product wafer reduction
 Maintenance
 Model-based process control:
 Physical and chemical process models
 Model-based sensors
 Soft sensor
 Virtual metrology
 Sampling plan
 Tool data analysis:
 Data collection
 Data acquisition
 Failure and Yield Analysis
 Statistical approaches
 Non-statistical approaches
 Data analysis, modeling and visualization:
 Data collection

<AEC/APC Symposium Asia 2011 ネットワークエキジビション参加申込規約>

1. ブースの転貸の禁止

ブース展示者は、自社分のブースを ISSM 事務局の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡はできません。

2. 共同申込者

2 社以上の申込者が共同で参加する場合、1社が代表して申し込み、共同参加する社名などを申し込み時に AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局へ通知するものとします。

3. 展示物の搬入、設置および搬出

ブース展示者は、AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局の定めるスケジュールに沿ってブース内の装飾、および展示物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中、展示物の搬入・移動・搬出の必要が生じた場合は、AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局の承認を得た後、作業を行うものとします。

4. ブースの使用

宣伝・営業活動はすべて割り当てブースの中に限られるものとします。

ブース展示者は、宣伝活動のためにブース近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。

展示物などいかなるものも、割り当てられた床の範囲を越えてはならないものとします。

AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局は、その音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物、ネットワーキングセッションの目的に沿わない展示物を禁止又は撤去する権限を有するものとします。この権限は、人・物・行為・印刷物等、AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局が問題があるとする性質のすべてに及ぶものとします。

上記の制限または撤去が行われた場合、AEC/APC Symposium Asia 2011 はブース申込者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。

5. 展示物の管理と免責

AEC/APC Symposium Asia 2011 は、ネットワーキングセッション会場の管理・保全について事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる各展示物の損失または損害についてその責任を負いません。

6. 損害賠償

ブース展示者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備またはネットワーキングセッションの建造物もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を負うものとします。

7. ネットワーキングセッションの中止

AEC/APC Symposium Asia 2011 は、ネットワーキングセッションが開催される土地建物が入場に不適当となった場合、または不当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することができます。AEC/APC Symposium Asia 2011 はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他展示者に生じた不利益な事態については責任を負わないものとします。

8. 参加料支払い方法

展示者は AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに参加料を支払いものとします。支払いは指定の銀行口座のみとなります。約束手形、小切手等の取り扱いはしません。

9. 解約について

原則として、ネットワーキング参加申込書確定通知後のキャンセルは認めません。やむなく取り消しをされる場合には文書にてご連絡下さい。この場合、下記のキャンセル料をお支払いいただきます。

申込書確定通知後～2011年8月31日まで	ブース料の50%
2011年9月1日以降	ブース料の100%

10. 規約の遵守

ブース申込者は、AEC/APC Symposium Asia 2011 が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。

11. 規約の変更と追加

ブース申込者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、AEC/APC Symposium Asia 2011 事務局の決定に従うものとします。